

## 版权转让协议

您的文章已经被《半导体学报》接收，作者必须在版权转让协议上签字，寄回《半导体学报》编辑部后，方能正式发表。具体刊登的年、卷、期将另行通知。

**文章编号：**

**文章题目：**

**全体作者姓名：**

遵照《中华人民共和国著作权法》，自本协议签署之日起，该文的版权(含网络版和光盘版等各种介质、媒体的版权)将无限期地在全世界范围内转让给《半导体学报》编辑部。该文刊登后，编辑部一次性付清稿酬。

作者可以行使下列各项权利。

1. 作者享有除版权以外的其他所有产权。
2. 该文在《半导体学报》上发表后，作者享有非专有权；作者可以准许第三方在不使用《半导体学报》版式并且不是用于在其他刊物上发表的前提下，重新出版该文或其译文或摘录，而无须获得《半导体学报》编辑部的许可。如使用上述刊物版式(含各种介质、媒体版式，下同)，则必须获得《半导体学报》编辑部的书面许可。
3. 该文在《半导体学报》发表后，作者有权在汇编个人文集或以其他方式(含作者个人网页中)出版个人作品时，不经修订地全部或部分使用该文上述版式。
4. 作者本人在学习、研究、讲演或教学中有权全部或部分地复制该文。
5. 作者享有在电子打印(出版)服务器上张贴或更新该文的权利，但为此目的不得使用《半导体学报》或其经销商制作的数字化并(或)版式化的文档。一旦该文被接受发表后，进行或更新此类张贴时均应附有与上述刊物的在线文摘或该刊物的进入主页的链接。
6. 如果该文作者是为完成法人或其他组织的工作任务所创作的作品属于职务作品范围，法人或其他组织有权在其业务范围内复制该文用于其个人内部使用。

作者在签署本协议时保证如下：

1. 文章内容是作者独立取得的原创性研究成果，未曾在国内外公开发表过，未一稿多投。
2. 文章内容不涉及保密及其他与知识产权有关的侵权问题；文中引述他人工作均已注明出处。
3. 文章内容不涉及任何猥亵或诽谤的内容。
4. 作者署名及署名顺序已经经过全部作者的审核和同意。
5. 不得许可他人以任何形式使用。
6. 此协议对于全体作者均具有约束力。签字之作者保证其本人具有签署此协议并做出各项承诺之全权。

选择下列方式之一签署版权转让协议：

- 我是作者之一，代表全体作者签字。
- 全体作者签字。

**文章内容不涉及保密事项。**

**(单位盖章)**

**作者签字：**

年 月 日